

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 9 日 (09.06.2005)

PCT

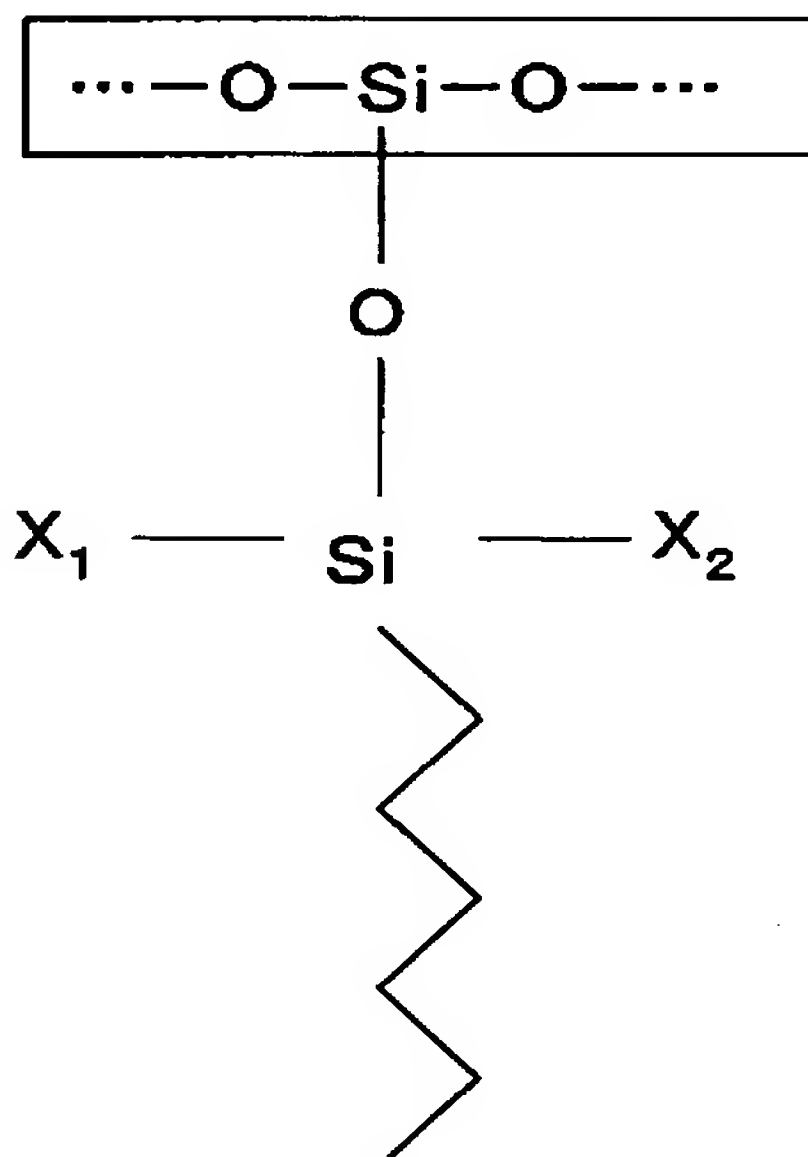
(10) 国際公開番号
WO 2005/052062 A1

- (51) 国際特許分類: C08L 101/00, (74) 代理人: 伊東 忠彦 (ITO, Tadahiko); 〒1506032 東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 20 番 3 号 恵比寿ガーデンプレイスタワー 32 階 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017294
- (22) 国際出願日: 2004 年 11 月 19 日 (19.11.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-394176
2003 年 11 月 25 日 (25.11.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社資生堂 (SHISEIDO COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1048010 東京都中央区銀座 7 丁目 5 番 5 号 Tokyo (JP). ユニチカ株式会社 (UNITIKA LTD.) [JP/JP]; 〒6600824 兵庫県尼崎市東本町 1 丁目 50 番地 Hyogo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高橋 俊 (TAKAHASHI, Shun) [JP/JP]; 〒2248558 神奈川県横浜市都筑区早渕 2 丁目 2-1 株式会社資生堂 リサーチセンター (新横浜) 内 Kanagawa (JP). 高田 素樹 (TAKATA, Motoki) [JP/JP]; 〒2248558 神奈川県横浜市都筑区早渕 2 丁目 2-1 株式会社資生堂 リサーチセンター (新横浜) 内 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

[続葉有]

(54) Title: RESIN COMPOSITION AND RESIN FORMED BODY

(54) 発明の名称: 樹脂組成物及び樹脂成形体



(57) Abstract: Disclosed is a resin composition wherein hydrolysis is suppressed and discoloring at the time of heating is reduced. Also disclosed is a resin formed body wherein hydrolysis is reduced. This resin formed body enables to reduce quality deterioration of the contents. The resin composition contains a resin and a lamellar organic silicic acid wherein a substituted silyl group having a substituted or unsubstituted alkyl group is bonded to a lamellar polysilicic acid. The resin formed body can be obtained by shaping such a resin composition which contains a resin and a lamellar organic silicic acid wherein a substituted silyl group having a substituted or unsubstituted alkyl group is bonded to a lamellar polysilicic acid.

(57) 要約: 加水分解を低減させ、加熱の際の変色を低減させた樹脂組成物、並びに加水分解を低減させ、内容物の変質を低減させた樹脂成形体を提供する。樹脂組成物は、樹脂及び置換又は無置換のアルキル基を有する置換シリル基が層状ポリケイ酸に結合した層状有機ケイ酸を含む。樹脂成形体は、樹脂及び置換又は無置換のアルキル基を有する置換シリル基が層状ポリケイ酸に結合した層状有機ケイ酸を含む樹脂組成物を成形して得られる。

WO 2005/052062 A1



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。